

Henkel auf der PCIM 2015

Know-how zum Wärmemanagement und revolutionäre Lotpaste

Die Messe PCIM (Power Conversion Intelligent Motion) in Nürnberg vom 19. bis zum 21. Mai ist für Henkel der ideale Ort, um auf seine neueste Portfolio-Erweiterung aufmerksam zu machen: Bergquist Wärmemanagement-Lösungen. Bergquist wurde Ende 2014 von Henkel übernommen und ist Marktführer bei Wärmemanagement-Materialien. Das Portfolio bildet jetzt eine Kernkomponente des Henkel-Lösungsangebots für seine weltweiten Kunden aus der Elektronikbranche. In Halle 9, Stand 520, wird das Henkel-Team an den Messetagen verschiedene innovative Wärmeleitmaterialien sowie seine neue revolutionäre Lotpaste und führende Halbleitermaterialien vorstellen.

Marktführer beim Wärmemanagement

Das effektive Wärmemanagement bei Leistungsbauteilen wird auf der diesjährigen PCIM ein zentrales Thema sein. Hier bieten die isolierten T-Clad-Metallsubstrate von Henkel eine robuste Lösung. Die von Bergquist entwickelten T-Clad-Substrate sind ideal geeignet für Anwendungen mit höheren Leistungsdichten, bei denen höhere Ströme die Regel sind. Durch die Minimierung der thermischen Impedanz und ihre hohe Wärmeleitfähigkeit ermöglichen die T-Clad-Substrate ein effektiveres Wärmemanagement als herkömmliche Leiterplatten. Anwendungen wie Motorsteuerungen für batteriebetriebene Fahrzeuge, LED-Leuchten und Leistungswandler profitieren beim Wärmemanagement von T-Clad.

An den drei Messetagen der PCIM zeigt Henkel in Live-Präsentationen das Aufbringen eines Gap-Fillers auf Leiterplatten in der Dosierzelle DC-CNC250 von RAMPF, Partner von Henkel für den Materialauftrag auf Leiterplatten. Die Gap-Filler sind ebenfalls Innovationen von Bergquist. Die flüssigen Wärmeschnittstellenformulierungen sorgen im Vergleich zu folienbasierten Produkten für mehr Flexibilität und lassen sich besser in automatisierte Prozesse integrieren. Die Gap-Filler sind in verschiedenen Formulierungen mit Leitfähigkeiten zwischen 1



und 4 W/m-K erhältlich und ermöglichen die Steuerung der Dicke, Anpassung an die Bauteiltopographie sowie die spannungsfreie Montage empfindlicher Bauteile. Mit flüssigen Gap-Fillern können Hersteller darüber hinaus das Aufbringen des Wärmeschnittstellenmaterials stärker automatisieren und so den Durchsatz erhöhen, bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtkosten.

Messebesucher, die mehr über die Gap-Filler erfahren möchten, können sich neben Gesprächen mit den Experten des Henkel-Teams am Stand auch im Rahmen einer technischen Präsentation informieren, die unter dem Titel „Thermally Conductive, Cure-in-Place Gap Filler as an Optimal Solution for High Efficient Cooling“ am 19. Mai um 11:40 Uhr im Ausstellerforum Halle 7-260 stattfindet (präsentiert von Holger Schuh, Produktmanager und Anwendungstechniker bei Henkel).

Neben diesen innovativen Materialien wird Henkel auf der PCIM auch die Wärmemanagement-Lösungen Sil-Pad, Gap-Pad Bond-Ply, Hi-Flow und Liquid-Bond vorstellen, ebenso wie die erfolgreichen Phasenübergangsmaterialien zur Wärmeableitung Loctite TCP 4000PM und das neu eingeführte Loctite TCP 7800NC für höhere Temperaturen. Beide Materialien sind für den Schablonendruck einer integrierten Schicht mit extrem geringem thermischem Widerstand auf Leistungsbauteilen ausgelegt.

Revolutionäre Lotpaste und Halbleitermaterialien

Henkel wird die PCIM auch dazu nutzen, der europäischen Elektronikbranche seine neueste Lotpastenentwicklung vorzustellen: Loctite GC 10. Diese weltweit erste temperaturstabile Lotpaste bietet den Herstellern eine herausragende Leistung und Kosteneinsparungen in der Logistik- und Verarbeitungskette. Dank der Temperaturstabilität von einem Jahr bei 26,5 °C bzw. von einem Monat bei bis zu 40 °C entfallen bei Loctite GC 10 aufwändige Kühlverpackungen, Übernacht-Transport und Kühlungslagerung. In der Verarbeitungslinie sorgt die Stabilität des Materials für eine erhebliche Verlängerung der Standzeiten und der Schablonenlebensdauer, und das ohne Anlaufzeit und bei gleichmäßigem und effizientem Druckauftrag. Auch das Reflow-Verhalten ist herausragend, mit einem erweiterten Reflow-Fenster und erhöhter Aktivität für bessere Ergebnisse bei Aktivierungstemperaturen zwischen 150 °C und 200 °C.

Neben der Lotpaste der nächsten Generation wird Henkel auch Halbleitermaterialien präsentieren, die speziell für die Anforderungen von Leistungsbauteilen entwickelt wurden. Loctite Ablestik ABP 8064T ist eine hochleistungsfähige Die-Attach-Paste mit einer Wärmeleitfähigkeit von 20 W/mK. Sie zeigt eine hervorragende Stabilität bei hohen Temperaturen und kann bei Anwendungen mit mittleren Leistungen Weichlote ersetzen. Ein weiterer Bereich, in dem Henkel über ein starkes Portfolio von Innovationen verfügt, sind Vergussmaterialien. Auf der PCIM können sich die Besucher zum Beispiel über Loctite Hysol MG 15F-MOD2 C informieren, ein Vergussmaterial mit hohem Tg-Wert (245°C), das mit der hochaktuellen Siliziumcarbid(SiC)-Technologie kompatibel ist und sich für Bauteilanwendungen mit hohen Spannungen und Leistungen eignet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.com/electronics und www.bergquistcompany.com. Für einen Termin auf der PCIM wenden Sie sich bitte per E-Mail an J.Stamm@bergquistcompany.eu.

Loctite ist eine eingetragene Marke der Henkel Gruppe mit Schutz in Deutschland und anderen Ländern.

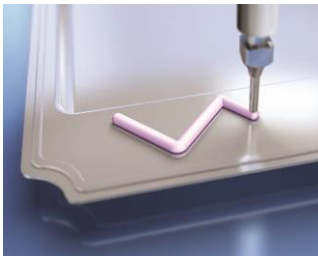
Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit fast 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2014 erzielte Henkel einen Umsatz von 16,4 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,6 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

Fotomaterial finden Sie im Internet unter <http://www.henkel.de/presse>

Kontakt	Lisa Kretzberg	Holger Elfes
Telefon	+49 211 797-56 72	+49 211 797-99 33
E-Mail	lisa.kretzberg@henkel.com	holger.elfes@henkel.com

Henkel AG & Co. KGaA

Folgendes Fotomaterial ist verfügbar:



Aufbringen eines Gap-Fillers